



Maximale Leistung – Silikon Gap Filler von RAMPF!

RAKU® SIL Gap Filler schützen empfindliche Bauteile vor Überhitzung und maximieren deren Nutzungsdauer. Aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit gewährleisten unsere Hochleistungs-Wärmeleitmaterialien (Thermal Interface Materials) eine effiziente Wärmeableitung bei gleichzeitig geringer mechanischer Belastung.



Vorteile

- Hohe Wärmeleitfähigkeit
- Geringe Dichte
- Minimale Sedimentation
- Geringer SVHC Gehalt
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Hohe Dauerwärmebeständigkeit



Typische Anwendungen

Power Electronics, Automotive-Elektronikbauteile, Computer und Peripheriegeräte, Anwendung zwischen Wärme erzeugenden Halbleiterbauelementen und Kühlkörpern.

Eigenschaften	Einheit	RAKU® SIL 27-1217	RAKU® SIL 27-1222	RAKU® SIL 27-1230-2
Farbe		Blau	Blau	Blau
Viskosität A-Komponente bei 20 °C	mPa·s	140.000	300.000	120.000
Viskosität B-Komponente bei 20 °C	mPa·s	130.000	300.000	150.000
Verdoppelung der Mischungsviskosität bei 20°C	mPa·s	140.000	300.000	140.000
Mischungsverhältnis A : B	Gew. TI	100 : 100	100 : 100	100 : 100
Topfzeit bei 20 °C	min	28	20	7
Dichte	g/mL	1,90	2,00	2,5
Härte bei 24 Stunden 20 °C	Shore 00	67	72	67
Anwendungstemperaturbereich	°C	-40 bis +200	-40 bis +200	-40 bis +200
SVHC-Gehalt	ppm	< 100	< 100	< 100
Wärmeleitfähigkeit bei 20 % Verpressung ASTM D 5470 Typ 2	W/m·K	1,7	2,2	3,0